

Axcen Photonics Corp.
創威光電股份有限公司

2025年Q3法人說明會

股票代號：6530

免責聲明

- 本簡報之內容可能包括本公司基於從各項來源所取得的資訊，對於營運、財務狀況與企業發展情形的前瞻性預估。
- 因為包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、供應鏈變動、全球經濟局勢、匯率波動及其他本公司無控制力之風險等各種因素，實際的營運、財務狀況與企業發展情形，可能會與本公司於預測中明示或默示敘述有差異。
- 本簡報之內容若有對未來之前瞻性預估，僅反映本公司於發佈當時之看法。本公司並無義務於日後情況變更時，更新前瞻預估。

簡報大綱

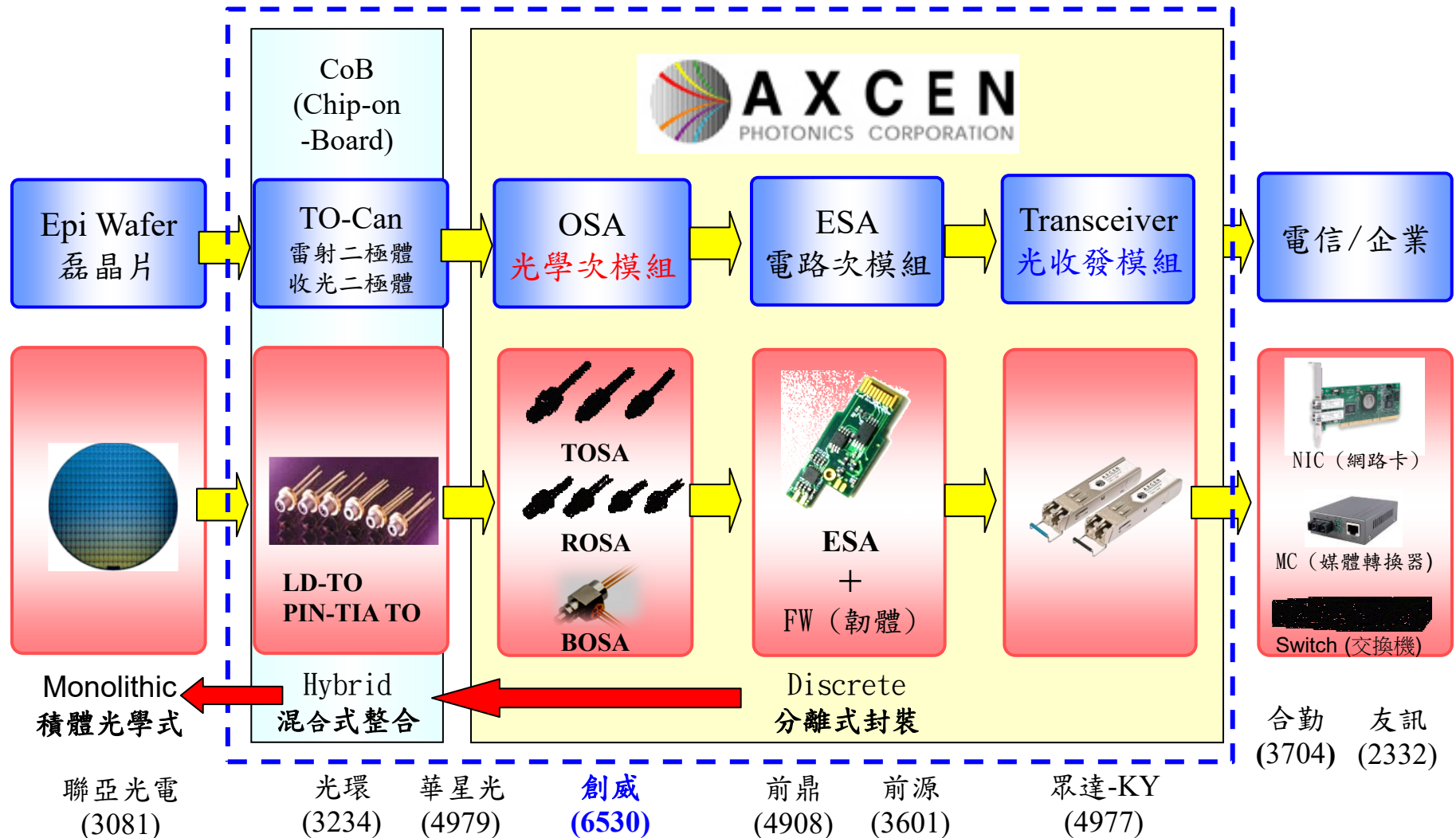
- 壹、公司簡介
- 貳、產業概況
- 參、產品簡介
- 肆、經營績效
- 伍、未來展望

壹、公司簡介

- 公司成立日期：2002年4月15日
- 實收資本額：新台幣337,500,000元
- 員工人數：73人(截至2025年9月30日)
- 董事長兼總經理：陳文宗
- 主要業務：光收發模組及光學次模組等光纖通訊相關產品之研發、生產與銷售
- 公司地址：新北市新店區寶中路119號6樓
- 公司上櫃日期：2018年1月23日



貳、產業概況-光通訊產業鏈(概圖)



貳、產業概況-全球光收發模組市場規模

研究機構	基準年份 (2024年左右) 規模 (十億美元)	預估終點年份	預估終點規模 (十億美元)	複合年成長率 (CAGR)
SNS Insider	\$8.75 (2022)	2030	\$27.33	15.3% (2023-2030)
Mordor Intelligence	\$13.57 (2025)	2030	\$25.74	13.66% (2025-2030)
Strategic Market Research	\$10.4 (2024)	2030	\$21.8	12.9% (2024-2030)
The Insight Partners	N/A	2031	\$36.73	14.2%
Bizwit Research	N/A	2030	\$32.97	17.0%
LightCounting (未來五年)	N/A	N/A	N/A	22% (受AI驅動，未來五年)

總體市場成長重點

- 1. AI 颶風效應：** LightCounting 等機構指出，用於 **AI 集群應用** 的乙太網光收發器需求強勁，預計未來五年的 CAGR 將高達 **22%**，遠高於過去的平均增長率。
- 2. 市場規模：** 到 **2030 年**，全球光收發模組市場規模預計將達到 **218 億美元至 330 億美元** 之間。
- 3. 主要驅動因素：**
 - **資料中心 (Data Center)：** 這是最大的應用市場(約佔 61%)，由雲端運算、AI/ML 和超大規模資料中心的擴張推動。
 - **5G 部署：** 電信市場對高速數據傳輸的需求，特別是在前傳 (fronthaul) 和回傳 (backhaul) 網路中。

叁、產品簡介-主要分類

光收發模組

熱插拔式



SFP28



SFP+



CSFP



SFP



BIDI SFP



Copper SFP

固定式



1X9



BIDI 1X9



GE PON



2X5 SFF

光學次模組



BoB Pigtail



BoB Receptacle

肆、經營績效-最近三年營運概況

單位:新台幣仟元

項目	2022年	2023年	YOY%	2024年	YOY%	2025年 第3季	YOY%
銷貨收入	274,207	251,831	-8.16%	280,934	11.56%	245,593	18.97%
毛利率	44.67%	42.86%		43.22%		45.98%	
營業利益	60,738	48,328	-20.43%	60,520	25.23%	59,703	35.92%
稅後淨利	53,776	42,218	-21.49%	55,396	31.21%	47,254	20.38%
稅後EPS (NT\$)	1.59	1.25		1.64		1.40	

伍、未來展望 - 產品技術進程

Discrete



Hybrid



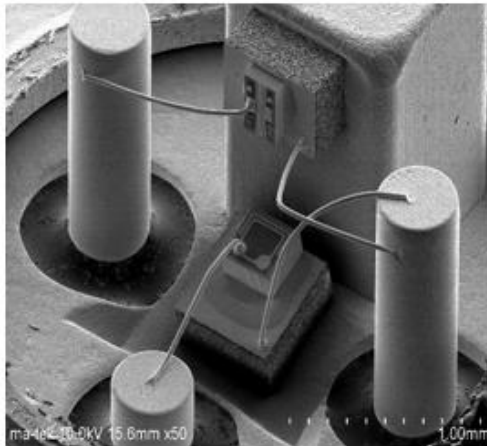
Monolithic

分離式元件封裝

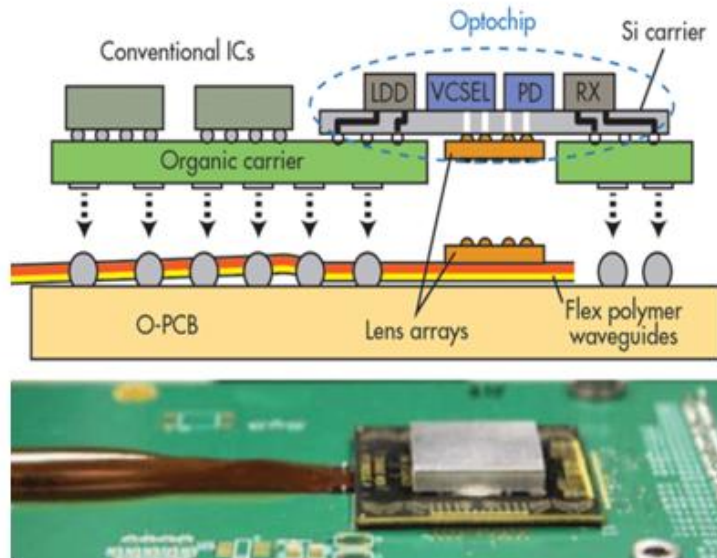
混合式元件整合

積體光學式

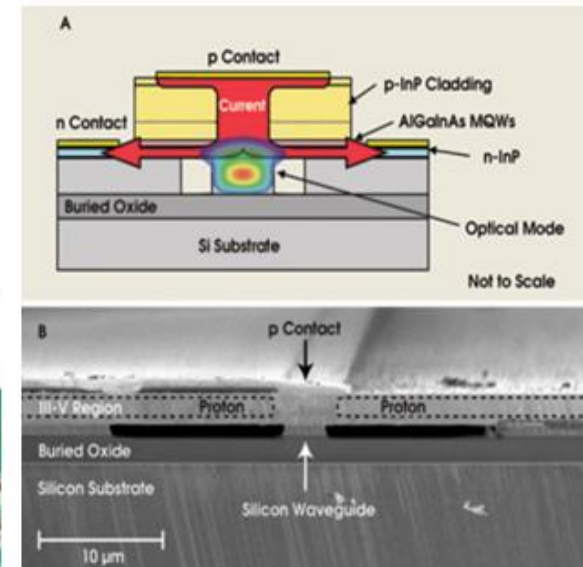
CoB (Chip-on-Board) or CoS (Chip-on-Substrate)
(LD, PD, IC, Optics 等 Chip 元件, 封裝整合到基板上)



Chip-on-Header

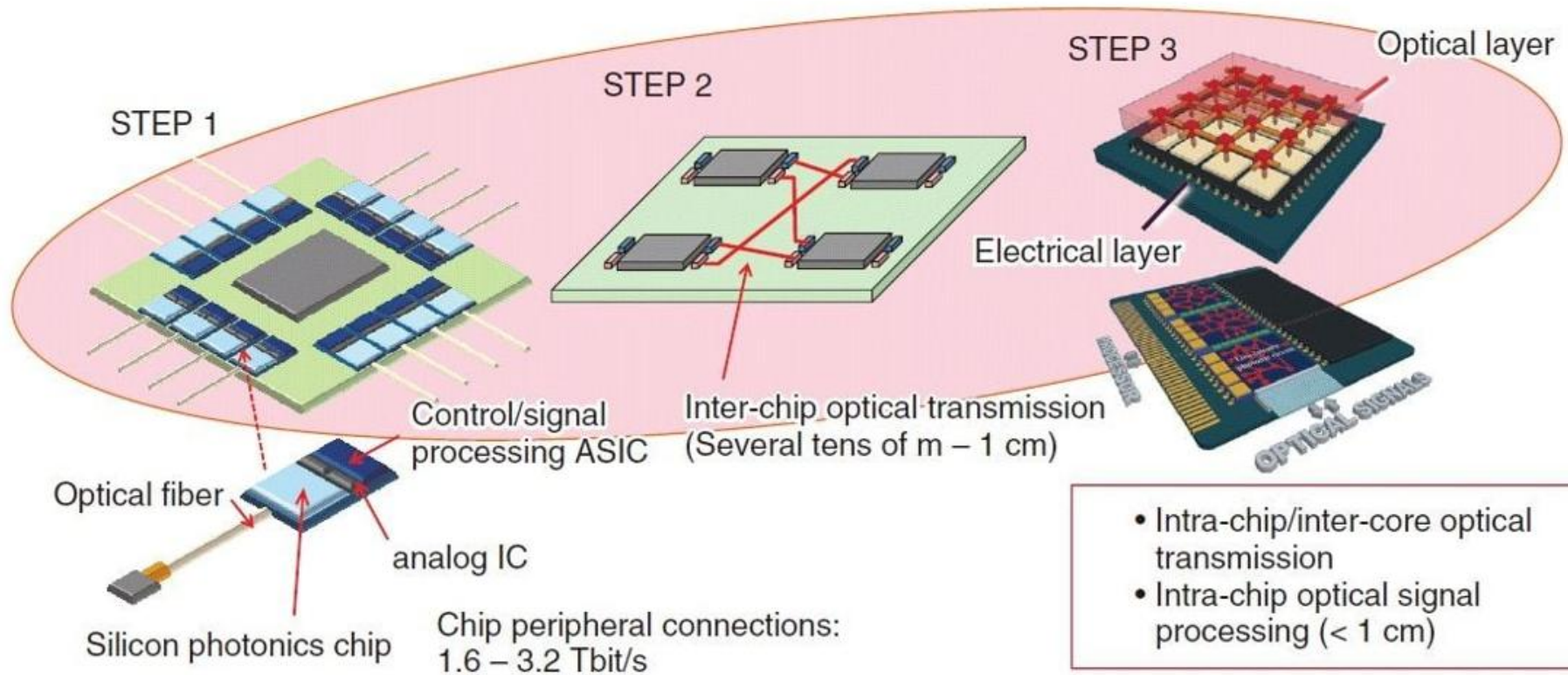


Chip-on-PCB



Chip-on-Silicon
(Si-Photonics)

伍、未來展望 - 產品技術進程

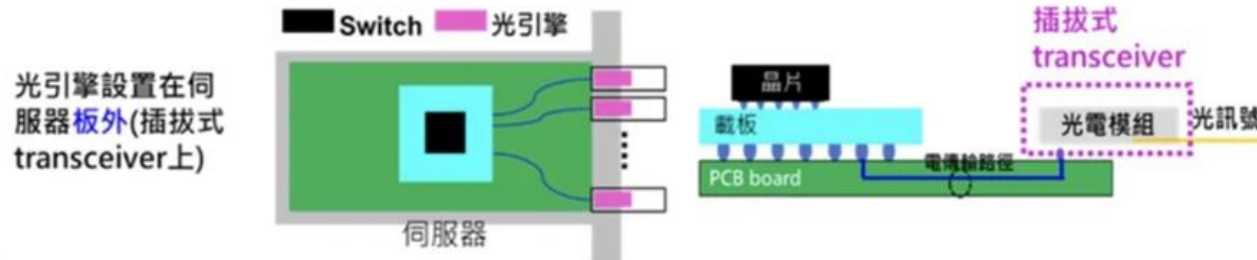


ASIC: application specific integrated circuit

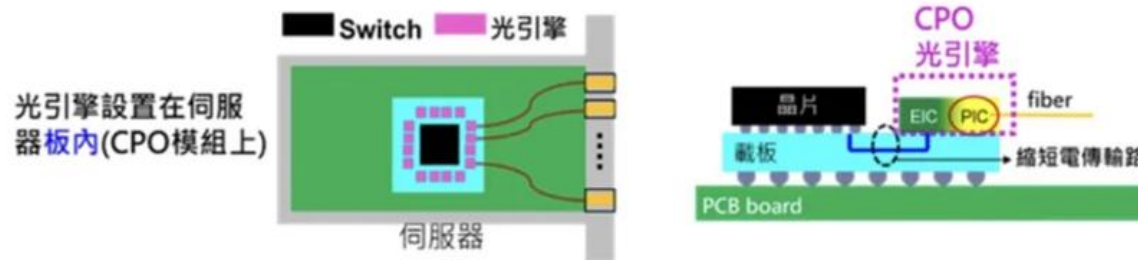
(資料來源：NTT Technical Review)

伍、未來展望 - 產品技術進程

(a) 插拔式光收發模組 (Transceiver) 架構

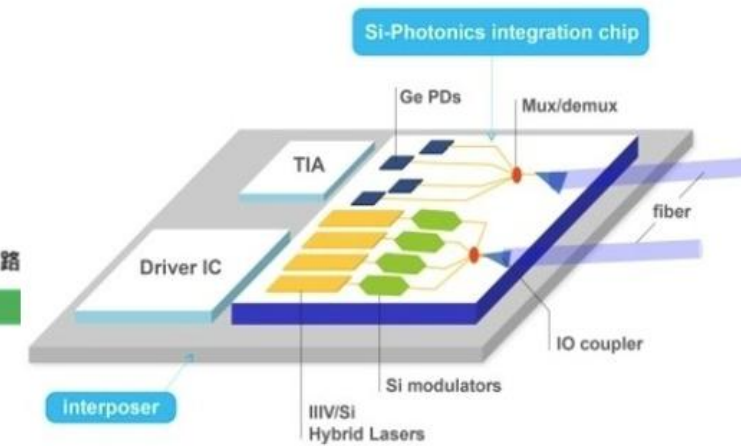


(b) 共封裝光學模組(CPO)架構



Axcen vs. SiPH

- ✓ Optical Coupling Design
- ✓ Optical Mux/DeMux Design
- ✓ CPO 共同封裝



(資料來源：工研院)

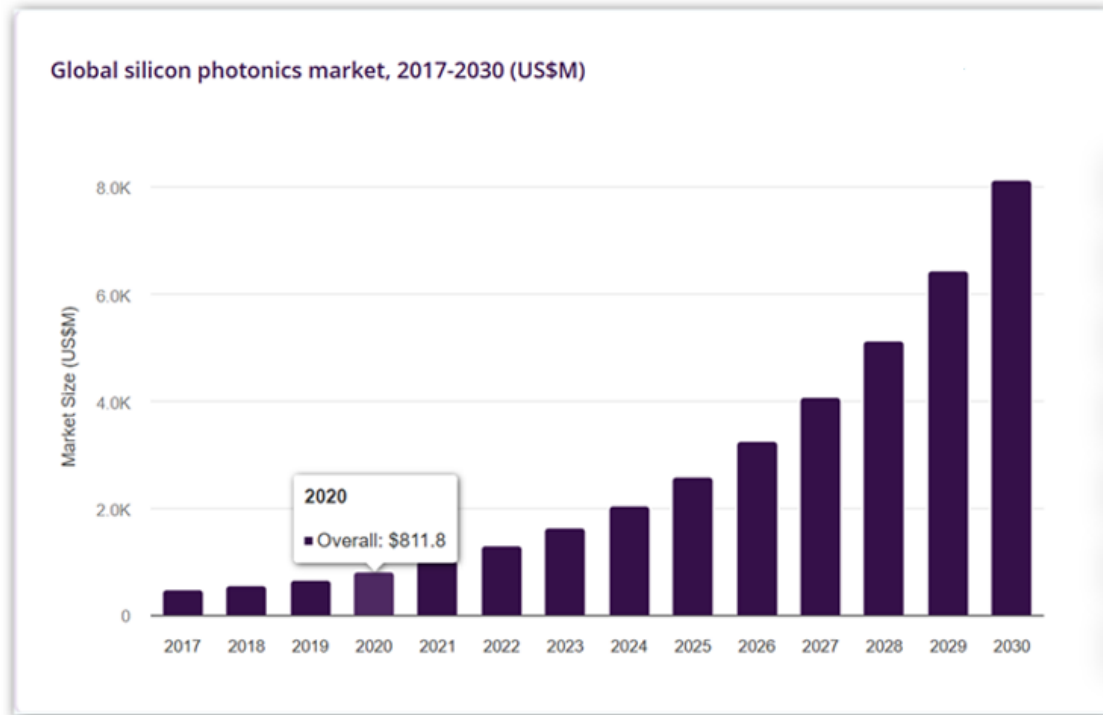
伍、未來展望－矽光子應用

矽光子主要應用

- 通訊
- 雲端運算
- AR/VR
- 光學感測
- 生物醫學
- 量子計算
- 量子通訊
- LiDAR（雷射探測與測距）

2017～2030年矽光子模組市場規模預估

（資料來源：Grand View Research, Inc.）



伍、未來展望 - 產品開發進程

400GBASE		-SR8(50Gx8)	-FR8(50Gx8)	-LR8(50Gx8)	-ER8(50Gx8)
200GBASE		-SR4(50Gx4)	-FR4(50Gx4)	-LR4(50Gx4)	-ER4(50Gx4)
100GBASE		-SR4(25Gx4)	-CWDM4(25Gx4)	-LR4(25Gx4)	-ER4(25Gx4)
50GBASE		-SR(PAM4)	-FR(PAM4)	-LxR(PAM4)	-ER(PAM4)
25GBASE	-T	-SR		-LR	-ER
10GBASE	-T	-SR	-LR-Lite	-LR	-ER
1000BASE	-T	-SX	-SX2	-LX	-LHX
	CAT	MMF	2km SMF	10km SMF	40km SMF

產品開發進程 (Product Roadmap) - 高速小型化(Higher Data-rate, More Compact)

SFP/
SFP+/
SFP28/
QSFP28



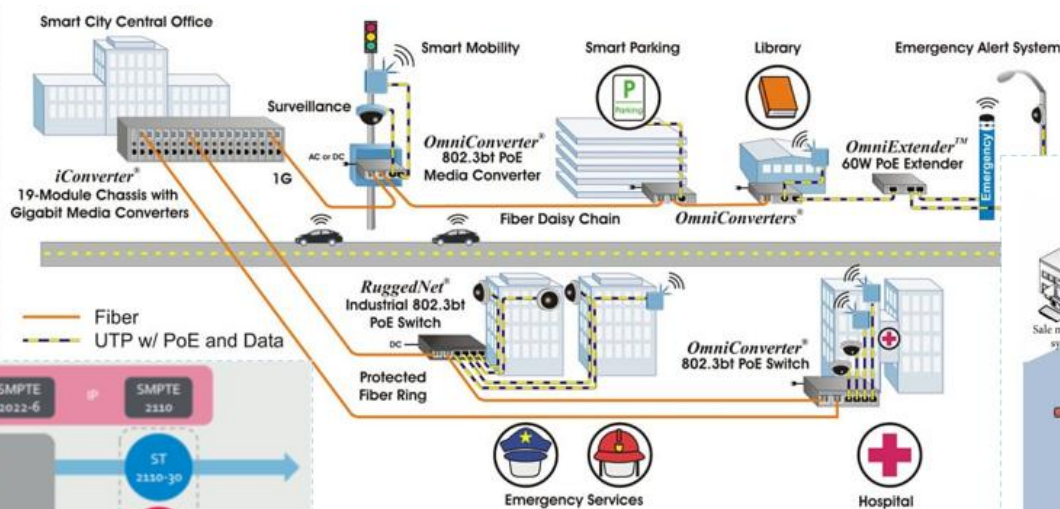
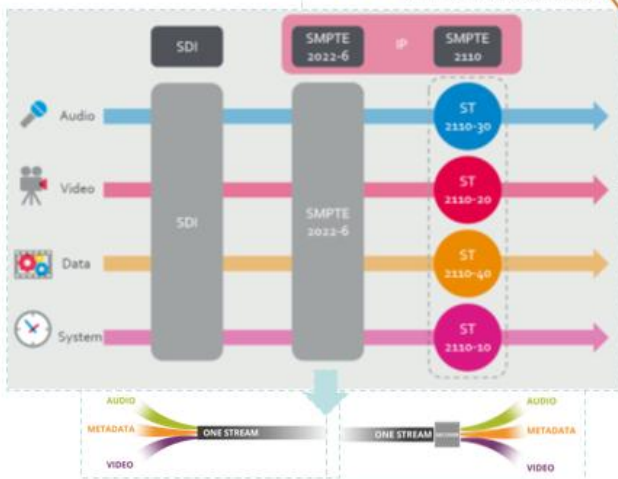
Available

產品開發進程 (Product Roadmap) - 產品應用：

(視聽影音、工業自動化/智慧工廠、智慧交通、...)

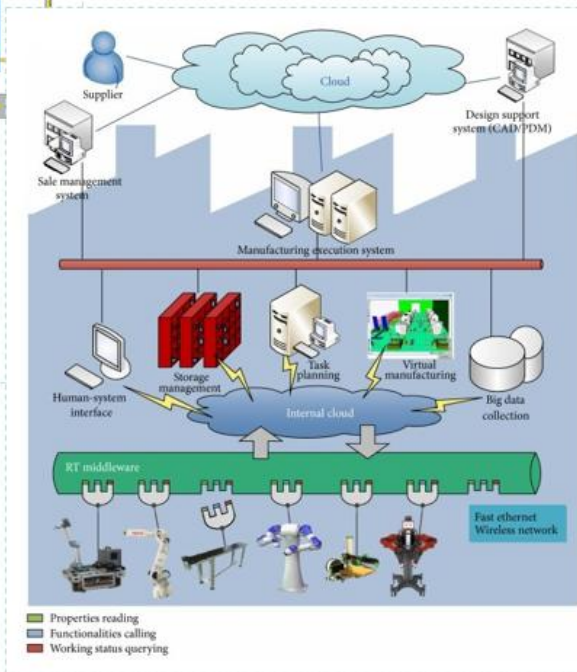
視聽影音

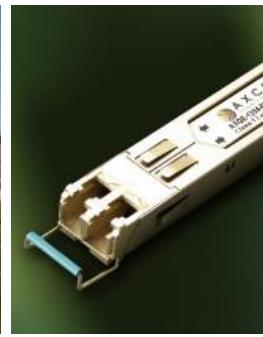
3G → 12G → 25G



智慧交通

工業自動化/智慧工廠





Q & A

